



平成 25 年 6 月 25 日

各 位

上場会社名	T O W A 株式会社
代 表 者	代表取締役社長 岡田 博和
コード番号	6315 (東証・大証 1 部)
問合せ先責任者	執行役員管理本部長 岸本 昌利
	TEL (075) 692 - 0251

## 中国市場への新製品 (マーケットイン型) 投入に関するお知らせ

当社は、最先端の独自技術であるコンプレッション方式のモールドイング装置によって、世界の半導体メーカー各社から高いご評価をいただいております。これからもこのコンプレッション技術は、今までに無い半導体デバイスを世の中に生み出すブレークスルーになるものと自負しております。

一方、当社グループは、お客様や地域ごとの特性により当社製品に要求される機能の違いや、お客様が生産される半導体デバイスの付加価値等から許容される製造装置への投資負担などを詳細に調査し、「マーケットイン型」のコンセプトで開発した新製品を、下記のとおり中国市場へ投入いたします。

これにより当社グループは、コンプレッション方式のモールドイング装置とあわせて、全方位型の製品戦略、営業活動を展開してまいります。

### 記

#### 1、新製品名

『 Y L C - 1 1 2 0 』

#### 2、新製品の特長

当社グループは、120トンのプレス圧に対応できる製品として、「Y1E3120」を既にラインナップしております。今回、中国市場へ投入する新製品『 Y L C - 1 1 2 0 』は、この従来製品を、中国市場のお客様の特性やその市場での競合環境などを検討し、「マーケットイン型」をコンセプトに改良したものであります。『 Y L C - 1 1 2 0 』の主な特徴は以下のとおりであります。

##### (1) 部材の現地調達比率90%以上を実現

中国ローカルのサプライヤーやその供給能力等を十分に調査および精査し、部材の現地調達可能比率を飛躍的に引き上げました。その結果、新製品の部材は90%以上が現地調達となっております。これにより、デリバリータイムの短縮はもちろん、原価・コストの大幅な低減を実現いたしました。

##### (2) マーケットイン型の発想でコストダウン設計

半導体メーカーやアッセンブリーハウスは、それぞれ得意とする分野や競合する市場などが異なることから、製造装置に求められる要素は様々であり、その優先順位も異なります。当社グループの従来製品の基本設計は、このような様々なご要望にお応えできるよう、たくさんの便利機能を搭載し、あらゆるオプション仕様にも対応できるものであります。しかしながら今回投入する新製品では、中国市場のお客様の特性やご要望を徹底的に調査し、「マーケットイン型」の発想で設計から見直したものであります。機能やオプション対応は限定されるものの、部品点数の削減やユニットの鋳物化等により製品原価を大きく引き下げ、安価な製品価格での販売を可能にしました。これによりお客様は、製品の生産性や品質は高い水準を維持したままで、初期投資を格段に抑えることが可能となります。

(3) 現地生産・現地出荷の体制

新製品の生産は、全て当社グループの中国工場（TOWA半導体設備（蘇州）有限公司）で一環生産し、工場からお客様へ直出荷・据付・トレーニングまで出来る体制を整えました。

3、新製品の販売開始時期

2013年7月を予定

4、今後の展開

半導体市場では、高機能・高密度化を競う最先端の実装技術に加え、低価格・短納期を競う生産技術においても熾烈な競争が繰り広げられております。今回、当社グループは、先ず中国地域において「マーケットイン型」をコンセプトに開発した新製品を投入いたします。そして今後は、東南アジアや韓国、台湾など中国以外の量産地域においても同様の展開を行ってまいります。また、北米での好結果を受けて、欧州などの量産地域以外においても「お客様のより近くでの活動」を強化し、「マーケットイン型」の開発を推進することによって、当社グループのお客様が半導体市場において競争優位を実現できるよう取り組んでまいります。

以上